

Bluetooth™ 用チップセット パッケージ

Chipset Package for Bluetooth™

Bluetooth™ 向モジュールに使用されるパッケージ・ソリューション

Flip Chip 100ピン

FLIP CHIPは多ピン/高密度化に対応するため、エリア状にパッドを配置し半田バンプを形成したChipです。
FLIP CHIPは電気特性に優れている事を特長とし、実装基板へ直接接続するため、実装面積の最小化が可能です。

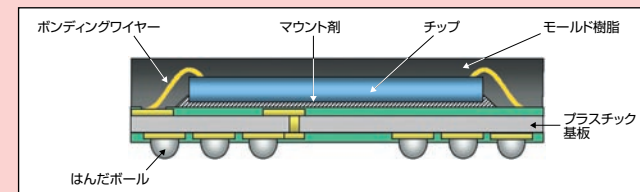


【Base Band用Package仕様】

- ◆外形(Chip)サイズ: 4.5mm×4.5mm
- ◆ボールピッチ: 0.4mm
- ◆取り付け高さ: 0.8mm Max
- ◆外部端子数(ボール数): 100ピン

PFBGA 113ピン(1.2mm厚)

PFBGAはPlastic Finepitch Ball Grid Arrayの略称です。
PFBGAは小型・薄型・低コストを特長とし、主にPC、DVC、携帯電話に使用されています。
外部端子数(はんだボール)は100ピン前後から300ピン以下をカバーしており、ボールピッチは0.8mm、0.65mmです(0.5mm開発中)。
プラスチック基板の上にチップをマウント、ワイヤーボンディング、モールドした構造です。

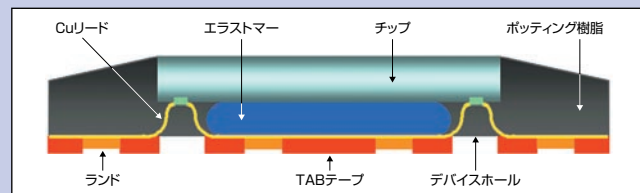


【Base Band用Package仕様】

- ◆外形サイズ: 8mm×8mm
- ◆ボールピッチ: 0.65mm
- ◆取り付け高さ: 1.2mm Max
- ◆外部端子数(ボール数): 113ピン

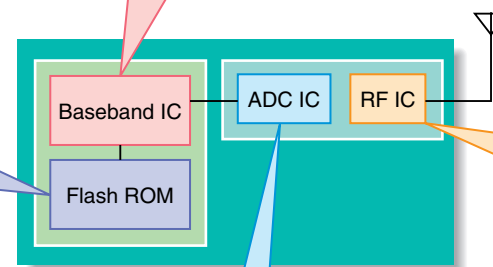
μLGA 43ピン(0.65mm厚)

μLGAはMicro Land Grid Arrayの略称です。
μLGAは小型・薄型・軽量を特長とし、主にBluetooth、モバイル機器などに使用予定です。
ランド径30μm Max、取り付け高さ0.65mm MaxでありTABテープ上にエラストマーを介しチップをマウント、Cuリードをシングルポイントボンディング、ポッティング樹脂封止した構造です。



【Flash Memory用Package仕様】

- ◆外形サイズ: 9.6mm×5.0mm
- ◆ランドピッチ: 0.75mm
- ◆取り付け高さ: 0.65mm Max
- ◆外部端子数(ランド数): 43ピン

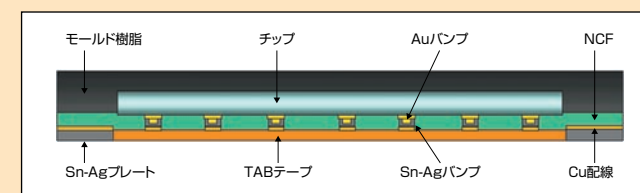


TQON

24ピン(0.5mm厚)

TQON 36ピン(0.5mm厚)/48ピン(0.5mm厚)

TQONはThin Quad Outline Non-Leadedの略称です。
TQONは小型・薄型・軽量・電気特性に優れている事を特長とし、主に携帯電話/モバイル機器などに使用されています。
外形的には16pinから48pinまでをカバーしておりランドピッチは0.5mm、取り付け高さは0.5mm Max、チップをTABテープにフリップチップ接続させ片面モールドした構造です。



【RF用Package仕様】

- ◆外形サイズ: 4.9mm×4.9mm
- ◆外部端子ピッチ: 0.5mm
- ◆取り付け高さ: 0.5mm Max
- ◆外部端子数: 36/48ピン